

RL78/G11 グループ半田付け条件判定表

RL78/G11 GROUP "SOLDERING CONDITIONS TABLE"

R01ZZ0157XJ0100

本資料の内容は変更されることがありますので、納入仕様書で最新情報をご確認ください。
The contents of this document are subject to change, so please check the latest information by delivery specifications.

“○”：適用可, “—”：適用不可

“○”：applicable, “—”：not applicable

| パッケージ Package | 型名 Part Number | リフロー条件 Infrared Reflow | ウェーブ溶ダリング条件 Wave Soldering | 部分加熱条件 Partial Heating |
|---|----------------------------|---|---|--|
| X | X | RDK-J-000312(JP) (旧番号：SSD-A-M5658-2) (JP) RDK-J-000318-2(EN) (Old number：SSD-A-M5659-1) (EN) | RDK-J-000313(JP) (旧番号：SSD-A-M5660-3) (JP) RDK-J-000319-2(EN) (Old number：SSD-A-M5661-1) (EN) | RDK-J-000314-2(JP,EN) (旧番号：SSD-A-M5662-1)(JP) (Old number：SSD-A-M5663)(EN) |
| 10-pin plastic LSSOP (4.4 x 3.6 mm, 0.65 mm pitch) | R5F1051AASP R5F1051AGSP | ○ | ○ | ○ |
| 16-pin plastic SSOP (4.4 x 5.0 mm, 0.65 mm pitch) | R5F1054AASP R5F1054AGSP | ○ | ○ | ○ |
| 20-pin plastic LSSOP (4.4 x 6.5 mm, 0.65 mm pitch) | R5F1056AASP R5F1056AGSP | ○ | ○ | ○ |
| 24-pin plastic HWQFN (4 x 4 mm, 0.50 mm pitch) | R5F1057AANA R5F1057AGNA | ○ | — | — |
| 25-pin plastic WFLGA (3 x 3 mm, 0.50 mm pitch) | R5F1058AALA R5F1058AGLA | ○ | — | — |

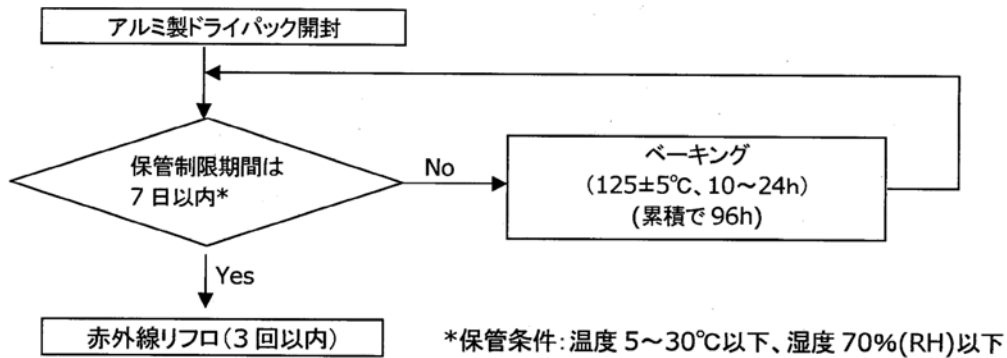
実装条件
赤外線リフロ方式のはんだ付け推奨条件
[温風、赤外線、温風リフロを含む]
吸湿量管理品

MSL3

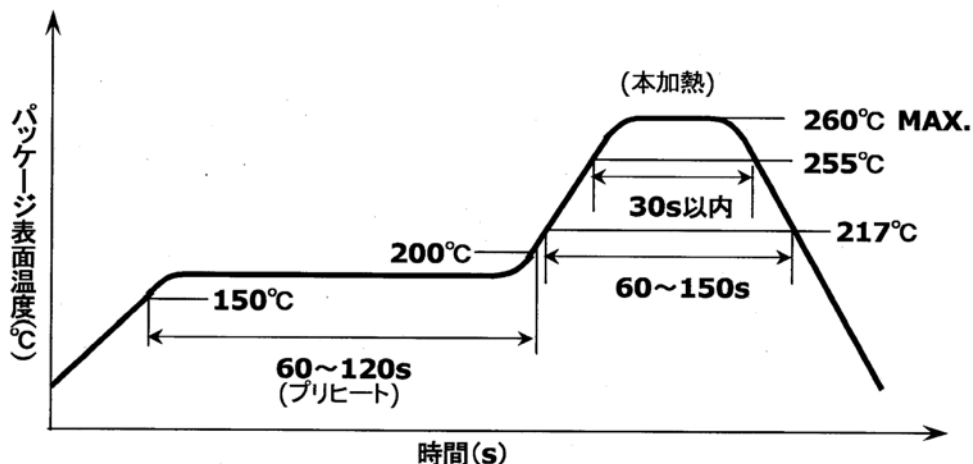
RDK-J-000312 1/1

ルネサス エレクトロニクス株式会社
Renesas Electronics Corporation

赤外線リフロ方式のはんだ付け推奨条件を下記に示します。



- ピーク温度(260℃の場合) : 260℃MAX
- ピーク温度(-5℃)の時間 : 255℃ 30s 以内
- はんだ融点以上(217℃以上の時間) : 60~150s
- プリヒート領域(150~200℃の時間) : 60~120s
- 最多リフロ回数 : 3回
- ドライパック開封後の保管制限期間 : 7日以内



<赤外線リフロ温度プロフィール>

留意事項

- ✓ 耐熱トレイ以外(マガジン、テーピング、非耐熱トレイ)は包装状態でのベーキングができません。
- ✓ インジケータの 30%検湿部が、ラベンダー色 又は ピンク色に変化していた場合は、ベーキングを推奨致します。
- ✓ はんだ溶融温度は使用される基板やペースト材料で異なりますので、実装温度プロフィールについては、本提示条件以下で最適温度をご確認の上、ご使用をお願いいたします。

Mount Conditions
RECOMMENDED SOLDERING CONDITIONS
OF INFRARED REFLOW

[INCLUDING CONVECTION, INFRARED/CONVECTION]

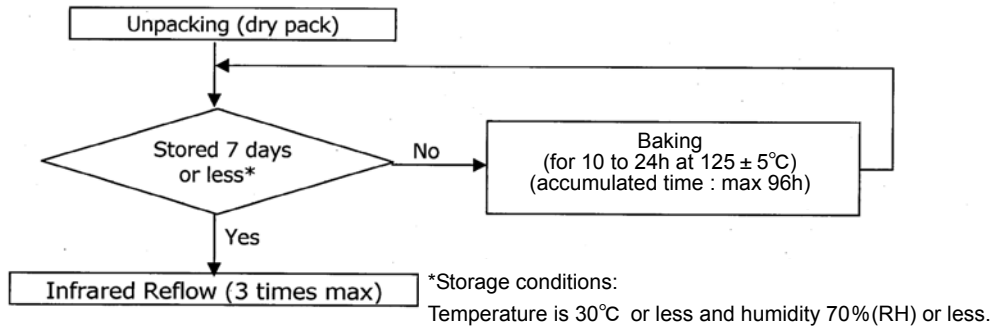
Moisture sensitive device

MSL3

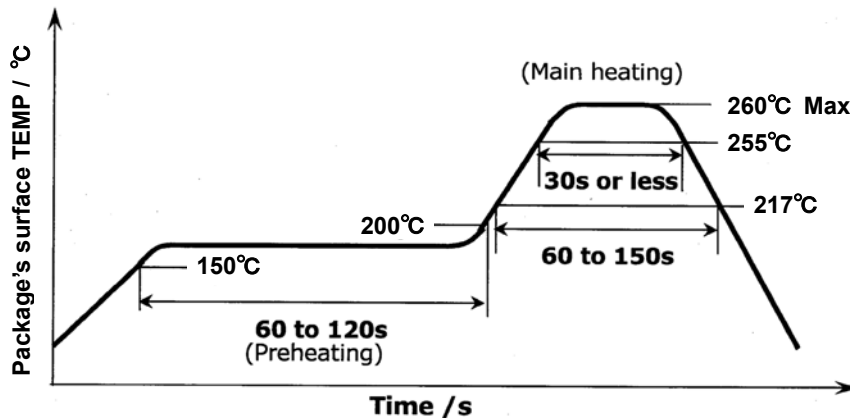
RDK-J-000318-2 1/1

Renesas Electronics Corporation

The following is recommended soldering conditions of infrared reflow.



| | |
|--|-----------------|
| Maximum temperature (Package's surface TEMP) | :260°C or below |
| Maximum time for temperature higher than 255°C | :30s or less |
| Time for temperature higher than 217°C | :60 to 150s |
| Preheating time (150 to 200°C) | :60 to 120s |
| Maximum number of reflow processes | :3 times |
| Keeping limitation period after opening dry pack | :7 days or less |



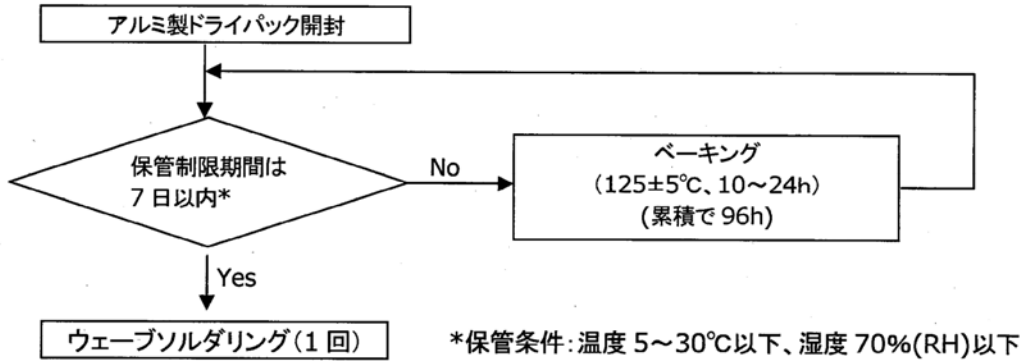
<Infrared Reflow Temperature Profile>

Notice

- ✓ For baking components, it is necessary to use heatproof type container. Plastic magazines, emboss tape/reels and some of trays are not heatproof type, so if the packing container is not heatproof type, please transfer them to a heatproof type container
- ✓ When the color of the humidity detection mark of 30% of the indicator has been changed into lavender or pink, it is recommended to execute the baking.
- ✓ Since solder melting temperatures differ with a substrate or the material of paste, please confirm the optimal temperature in the condition shown above before using components.

| | |
|--|---|
| <p style="text-align: center;">実装条件</p> <p style="text-align: center;">ウェーブソルダリング方式のはんだ付け推奨条件</p> <div style="border: 1px solid black; display: inline-block; padding: 2px;">吸湿量管理品</div> <p style="text-align: right;">MSL3</p> | RDK-J-000313 1/1 |
| | <p>ルネサス エレクトロニクス株式会社</p> <p>Renesas Electronics Corporation</p> |

ウェーブソルダリング方式のはんだ付け推奨条件を下記に示します。



- ピーク温度(はんだ温度) : 260°C以下
- ピーク温度の時間(一次+二次噴流通過時間) : 10s 以内
- 回数 : 1 回
- プリヒート温度(PKG 表面温度) : 120°C MAX
- プリヒート時間 : 制限無し

留意事項

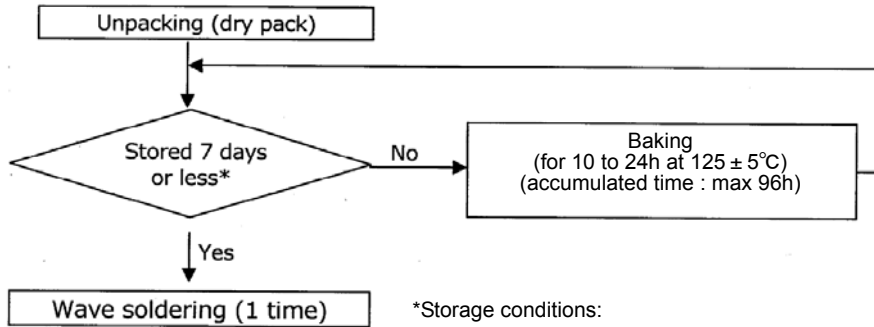
- ✓ 耐熱トレイ以外(マガジン、テーピング、非耐熱トレイ)は包装状態でのベーキングができません。
- ✓ インジケータの 30% 検湿部が、ラベンダー色 又は ピンク色に変化していた場合は、ベーキングを推奨致します。
- ✓ はんだ溶融温度は使用される基板やペースト材料で異なりますので、実装温度プロファイルについては、本提示条件以下で最適温度をご確認の上、ご使用お願いいたします。

Mount Conditions
RECOMMENDED SOLDERING CONDITIONS
OF WAVE SOLDERING
Moisture sensitive device

RDK-J-000319-2 1/1

Renesas Electronics Corporation

The following is recommended soldering conditions of wave soldering.



*Storage conditions:
Temperature is 30°C or less and humidity 70%(RH) or less.

| | |
|--|-----------------|
| Maximum temperature (Solder temperature) | :260°C or below |
| Time at maximum temperature | :10s or less |
| Maximum number of flow processes | :1 time |
| Maximum preheating temperature (Product's surface temp.) | :120°C or below |
| Maximum preheating time | :No limitation |

Notice

- ✓ For baking components, it is necessary to use heatproof type container. Plastic magazines, emboss tape/reels and some of trays are not heatproof type, so if the packing container is not heatproof type, please transfer them to a heatproof type container.
- ✓ When the color of the humidity detection mark of 30% of the indicator has been changed into lavender or pink, it is recommended to execute the baking.
- ✓ Since solder melting temperatures differ with a substrate or the material of paste, please confirm the optimal temperature in the condition shown above before using components.

